

2020年3月期 第2四半期 決算説明会

2019年11月18日



内外テック株式会社
JASDAQ3374

会社概要

代表取締役社長 兼 COO 岩井田 克郎

会社概要

所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が2本柱
従業員数	連結 558名 (2019年9月末)
連結子会社	内外エレクトロニクス 株式会社 納宜伽機材 (上海) 商貿有限公司

内外テックの営業所・物流センター・開発センター ○
内外エレクトロニクスの事業所・サービスセンター(SC) ★

中国・上海



納宜伽機材 (上海)



半導体製造工程概要



先行きの不透明感が残るも、IoTや5Gなどの需要増を背景にメモリ需要が拡大し、今後、前工程装置の設備投資の再拡大が見込まれる

内外テック
技術提案商社

+

内外エレクトロニクス
受託製造メーカー

= モノづくりができるメーカー商社

2020年3月期 第2四半期 実績

- **売上高・利益とも期初予想を上回るも、前年同期比減収減益**
⇒ **メモリの需給バランス調整、米中貿易摩擦の影響続く**

- **中長期的な半導体市場の拡大に備え、熊本県合志市に2019年9月土地建物を取得**
⇒ **九州物流センター：物流体制の強化**
⇒ **熊本サービスセンターの拡張：メンテナンス事業の強化**



期初予想を上回るも、前年同期比減収減益

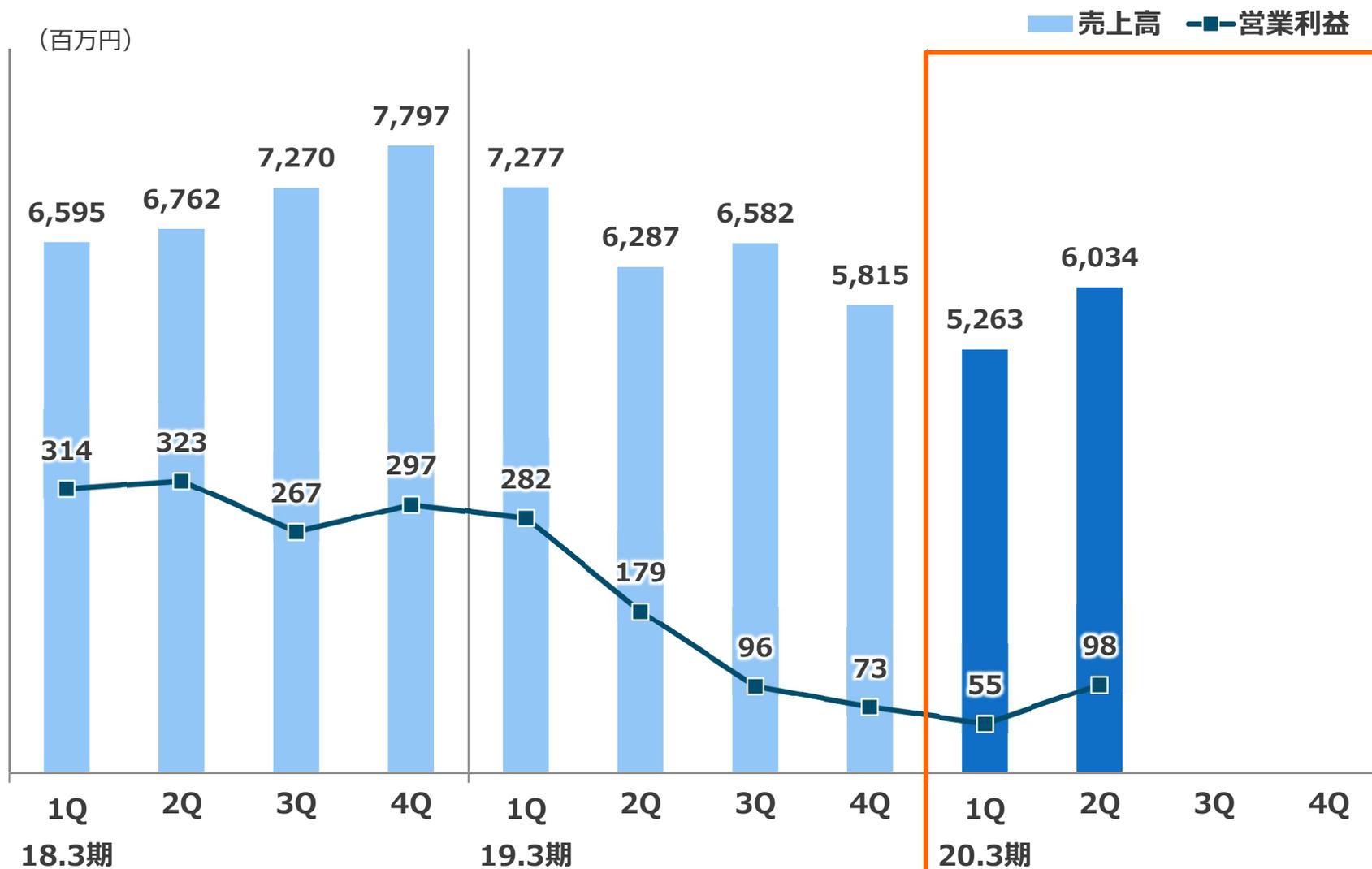
(百万円、%)

	2019.3期 上期			2020.3期 上期			期初予想
	実績	前年同期比	構成比	実績	前年同期比	構成比	
売上高	13,565	1.5	100.0	11,297	△16.7	100.0	10,275
売上原価	11,985	1.9	88.4	10,107	△15.7	89.5	-
販管費	1,117	16.2	8.2	1,036	△7.2	9.2	-
営業利益	462	△27.5	3.4	154	△66.6	1.4	96
経常利益	457	△26.7	3.4	146	△67.9	1.3	80
親会社株主に帰属する 四半期純利益	290	△30.0	2.2	77	△73.5	0.7	53

- 売上高は、メモリの需給バランス調整や米中貿易摩擦の長期化により、半導体メーカーの設備投資に慎重姿勢がみられるも、期初予想を上回る。
- 基幹システム構築に伴う減価償却費が増加するも、人件費の削減を中心に販管費を抑制。
- 各段階利益は、売上高の減少により前年同期比を大きく減少。

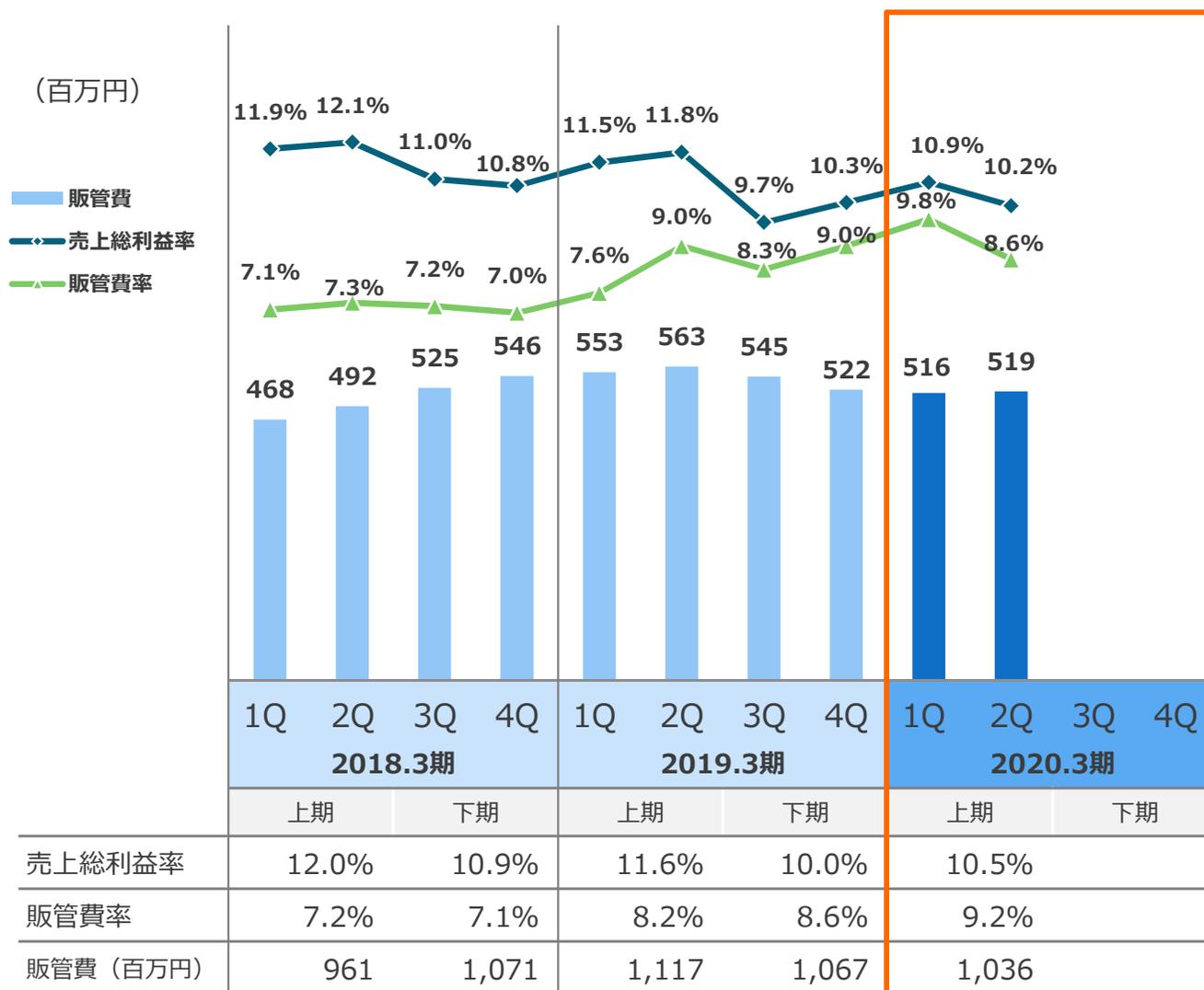
売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

売上高は、メモリの需給バランスが改善し、一部メーカーでは投資姿勢が強まり、1Qをボトムに回復傾向
営業利益は、売上高回復により増加



売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は、前3Qをボトムに回復傾向
販管費は、前4Q以降同水準で推移



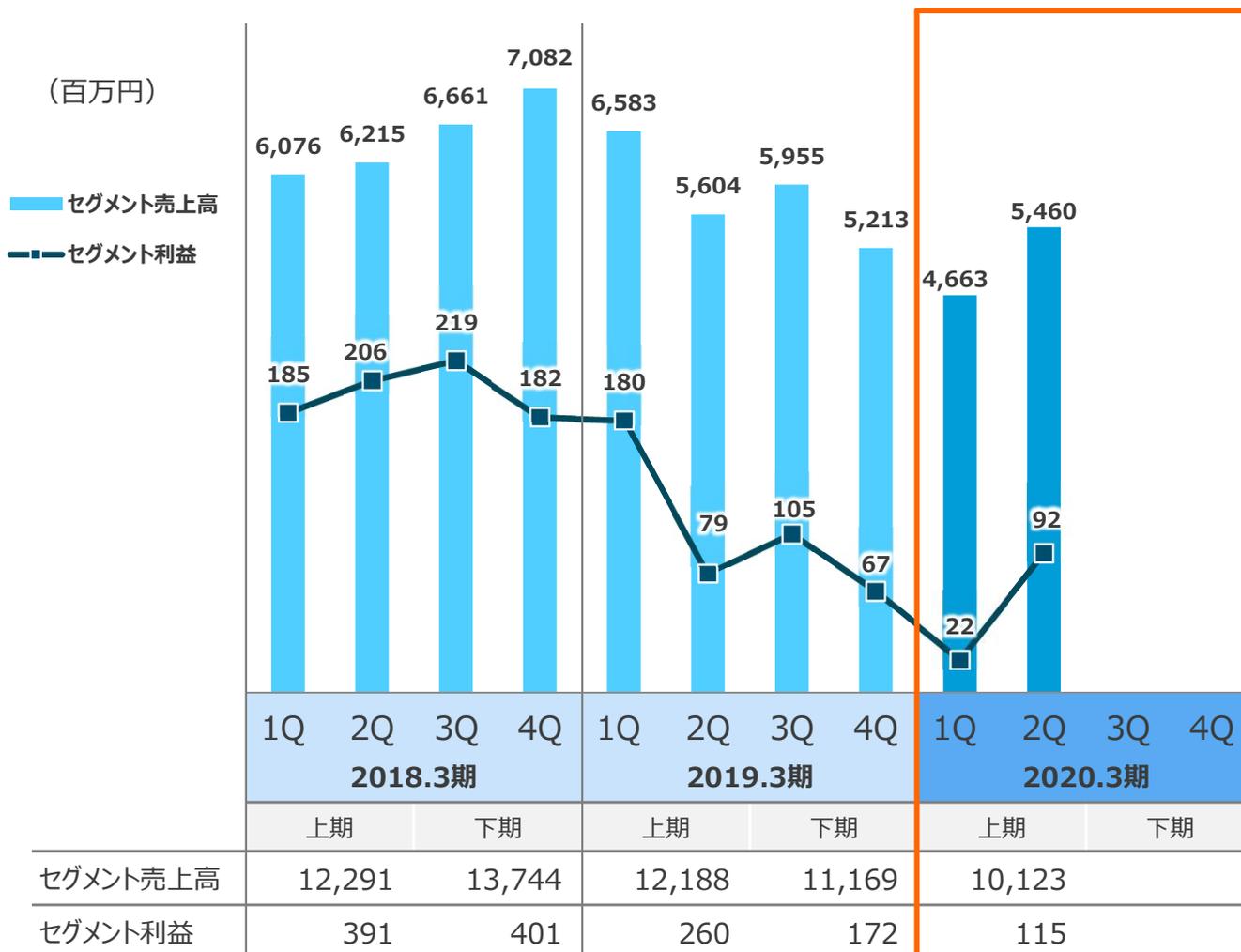
売上総利益率

- 販売先、受託機種バランス変化に伴い、前3Qをボトムに回復傾向。

販管費

- 一定の範囲で平準化
- 2Qの販管費率は、増収により1Qより低下

大幅な減収減益



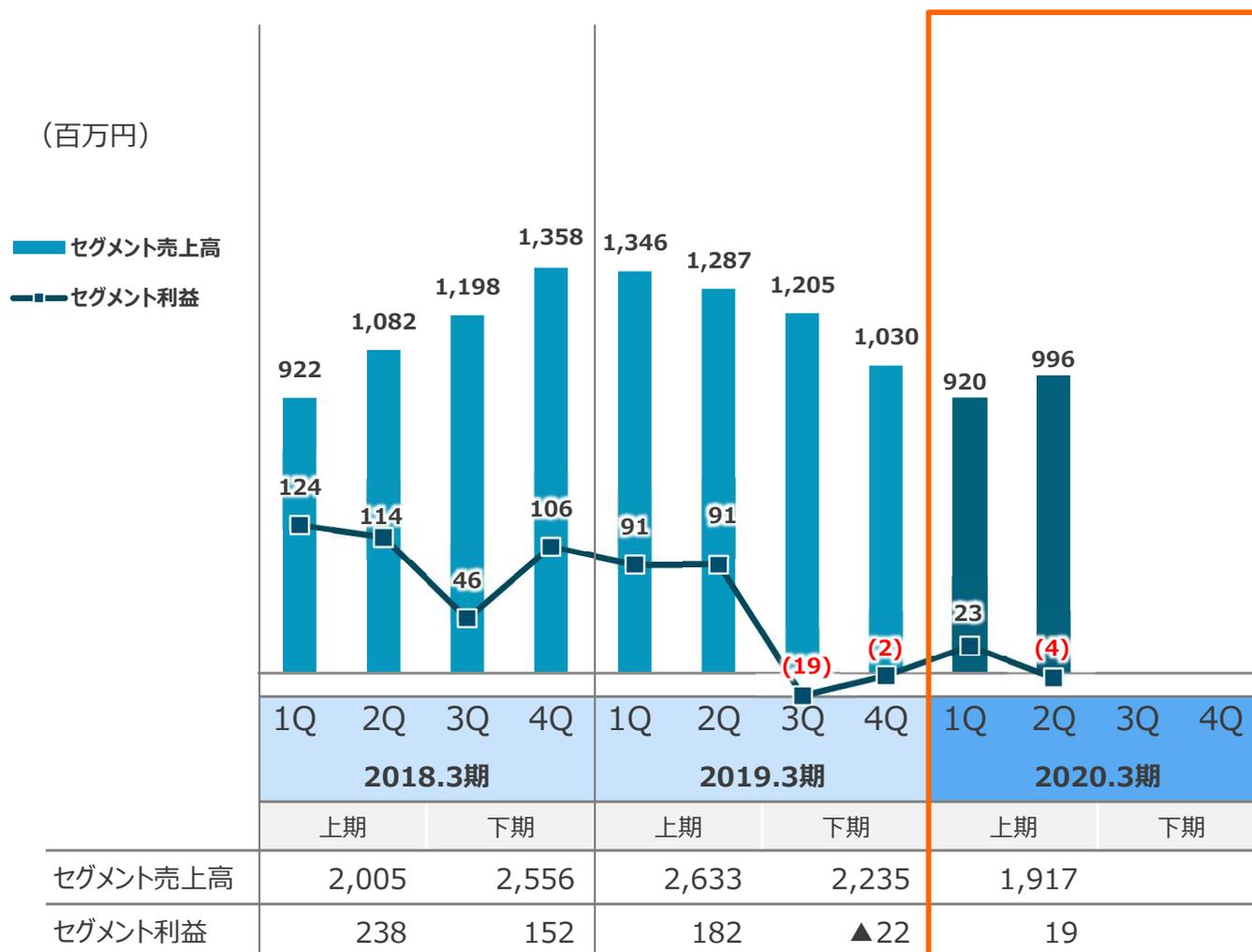
セグメント売上高 前年上期比 16.9%減

- 販売先の一時的な生産調整から大きく減少。
- 1Qから2Qにかけて回復が見られる。

セグメント利益 前年上期比 55.7%減

- 売上高減少に伴い、セグメント利益減少。
- 売上回復に伴い、2Qは前3Qに近い水準まで急回復。
- 物流等の人件費を中心に販管費を抑制。
- 基幹システム構築に伴い、減価償却費増加。

大幅な減収減益



セグメント売上高 前年上期比 27.2%減

- 販売先の一時的な生産調整から大きく減少。
- 販売事業に比べ回復にやや遅れ。

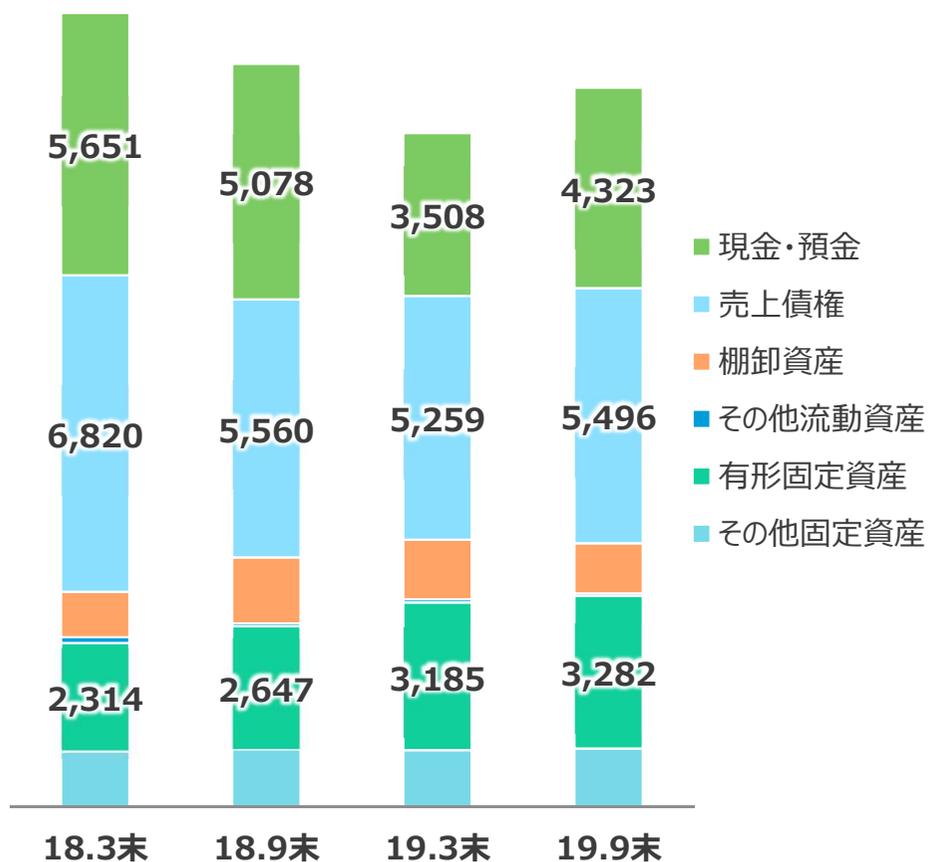
セグメント利益 前年上期比 89.6%減

- 売上高減少に伴い、セグメント利益減少。
- 設備増強に伴い、減価償却増加。
- 労務費を中心に人件費を削減するも、市場の再拡大に備え一定人員を確保。

貸借対照表

◆ 資産

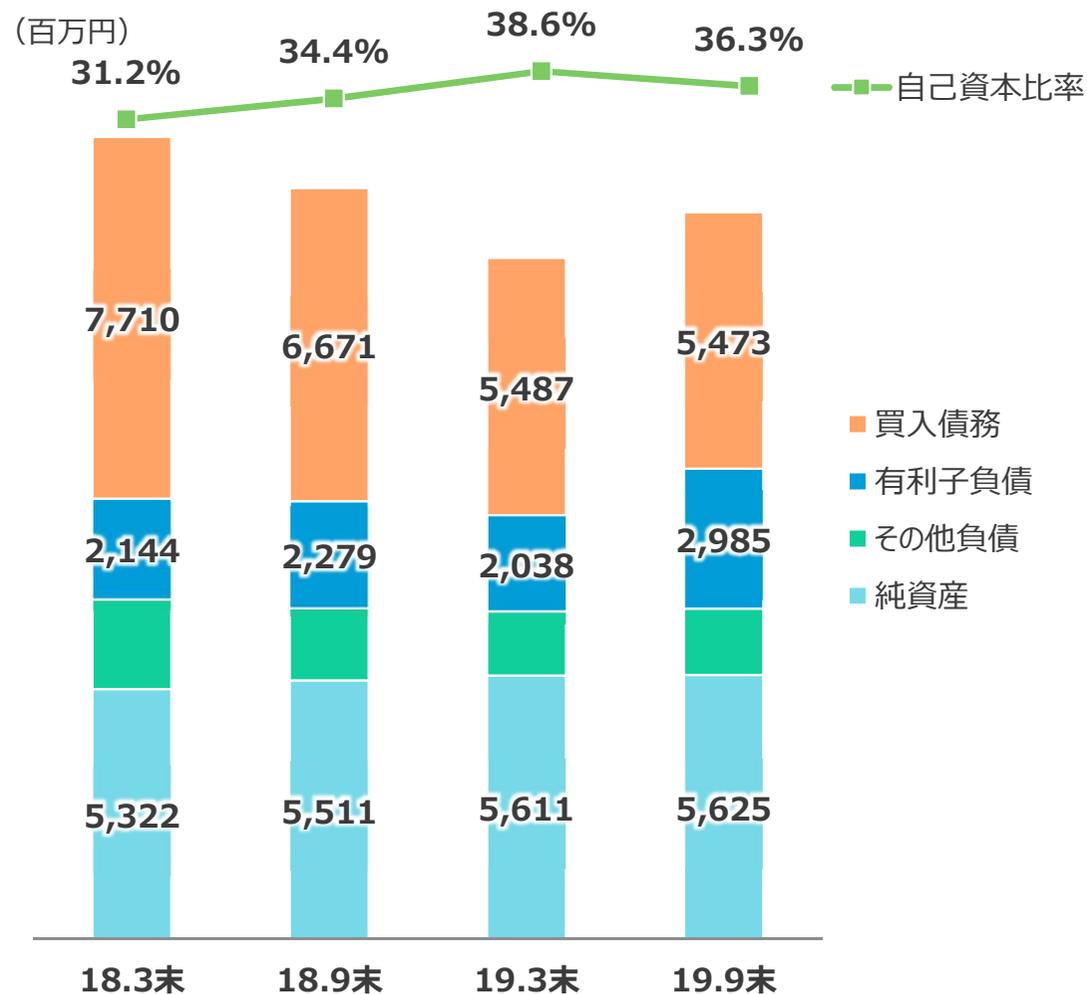
(百万円)



- 現金・預金は8億15百万円増加(借入による資金増加)
- 内外テックの九州物流センター、内外エレクトロニクスの熊本サービスセンターの取得により有形固定資産は19.3末比96百万円増加。

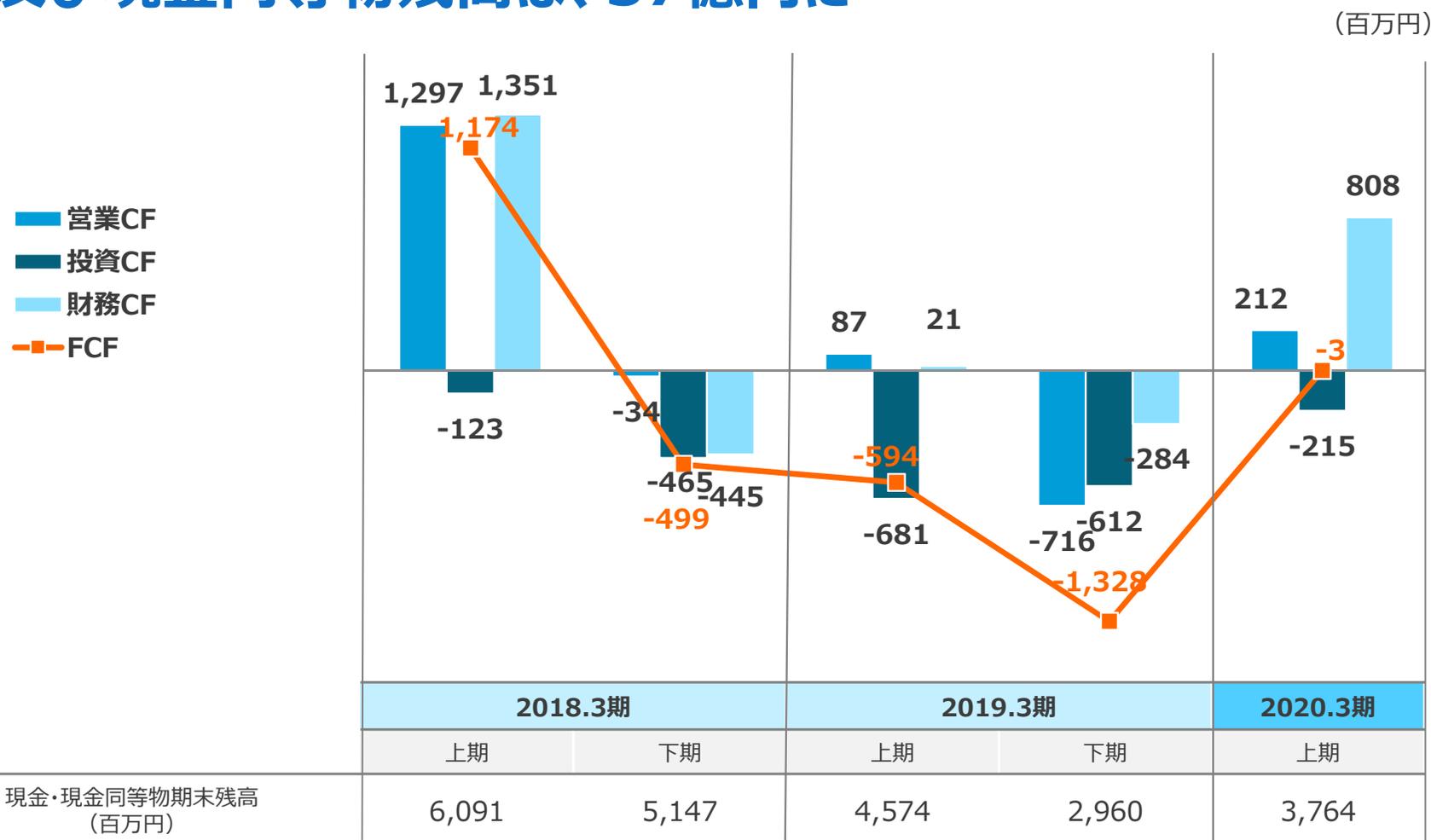
◆ 負債・純資産

(百万円)



- 純資産は微増。有利子負債の増加により総資産増加し、自己資本比率は36.3%に低下。
- 有利子負債は9億48百万円増加。

2018年3月期からの体制強化に向けた設備投資はほぼ完了 現金及び現金同等物残高は、37億円に



- たな卸資産の削減、利益の積上げにより営業キャッシュフローは212百万円。
- 体制強化に向けた固定資産取得により投資キャッシュフローは△215百万円。
- 長期借入金の調達により財務キャッシュフローは808百万円。

2020年3月期 予想

2020年3月期 業績予想（変更なし）

需給改善による半導体メモリ市況に回復傾向が見られるも、先行き不透明感から期初計画を据え置き

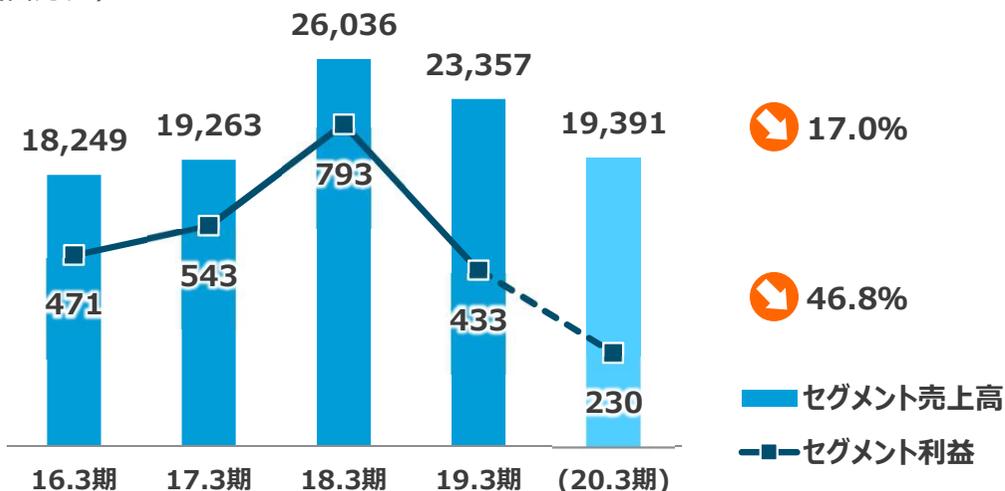
(百万円、%)

	2019.3期			2020.3期				
	実績	前期比	構成比	予想	前期比	構成比	上期	上期進捗率
売上高	25,963	△ 8.7	100.0	21,900	△15.6	100.0	11,297	51.6
売上原価	23,146	△ 8.1	89.2	19,398	△16.2	88.6	10,107	52.1
販管費	2,184	7.4	8.4	2,026	△ 7.2	9.3	1,036	51.1
営業利益	632	△47.4	2.4	475	△24.8	2.2	154	32.4
経常利益	621	△47.5	2.4	443	△28.7	2.0	146	33.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	409	△52.2	1.6	300	△26.8	1.4	77	25.7

セグメント予想（変更なし）

◆ 販売事業

(百万円)



セグメント売上高 前期比 Δ 17.0% 

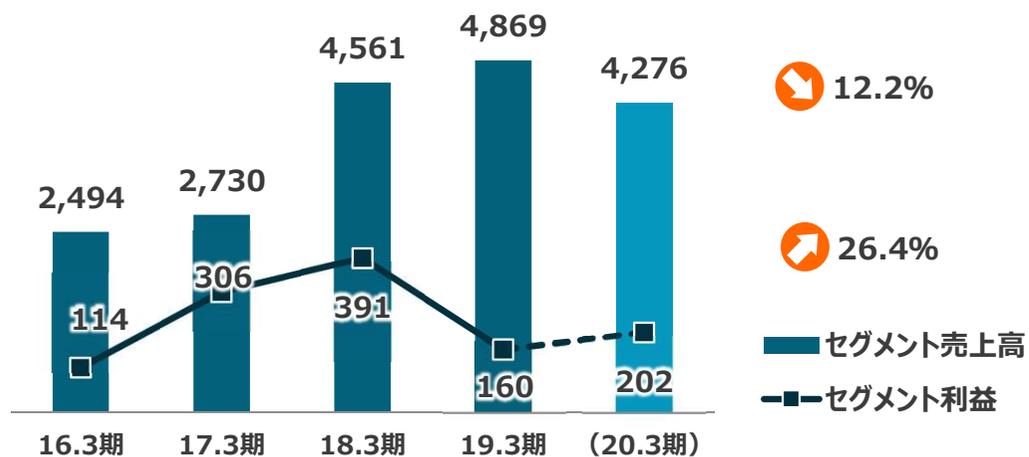
● 半導体メーカーの在庫調整が進むも、米中貿易摩擦など先行き不透明感から期初計画を据え置き。

セグメント利益 前期比 Δ 46.8% 

● 販管費の削減を進めるも、売上高の減少から前期比大幅減益を予想。

◆ 受託製造事業

(百万円)



セグメント売上高 前期比 Δ 12.2% 

● 下期受注回復を見込むも、米中貿易摩擦など先行き不透明感から期初計画を据え置き。

セグメント利益 前期比 26.4% 

● 間接部門の合理化を中心とした製造原価の抑制により収益改善を見込む。

(注) 数字は連結調整前

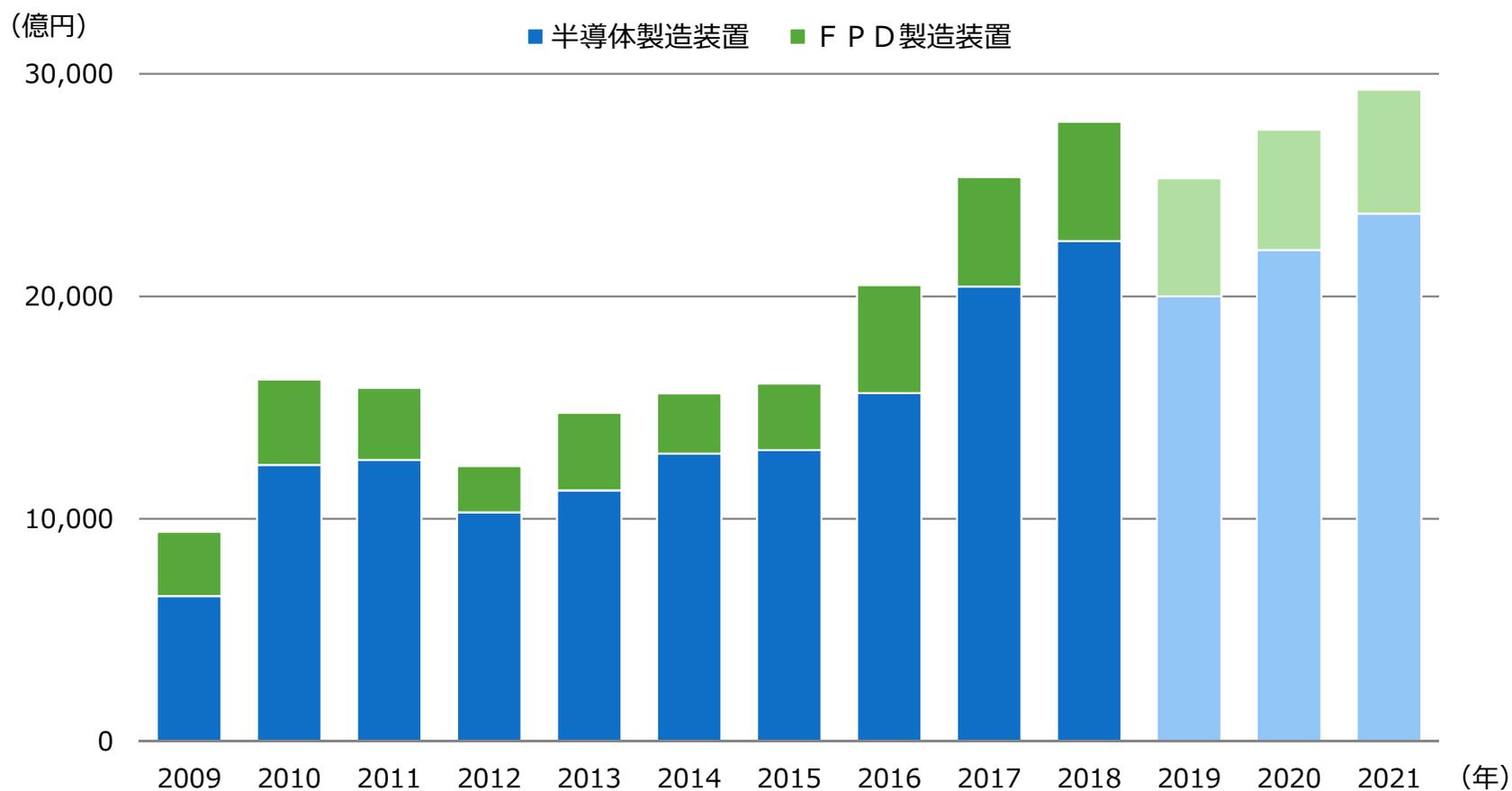
今後の成長に向けて

代表取締役会長 兼 CEO 権田 浩一

日本製半導体製造装置販売高は、2019年に減少するも、2020年以降再拡大を見込む

- 2019年7月4日に2019年の半導体製造装置市場予測を下方修正（SEAJ）

半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



(SEAJ 2019年7月4日発表資料をもとに作成)

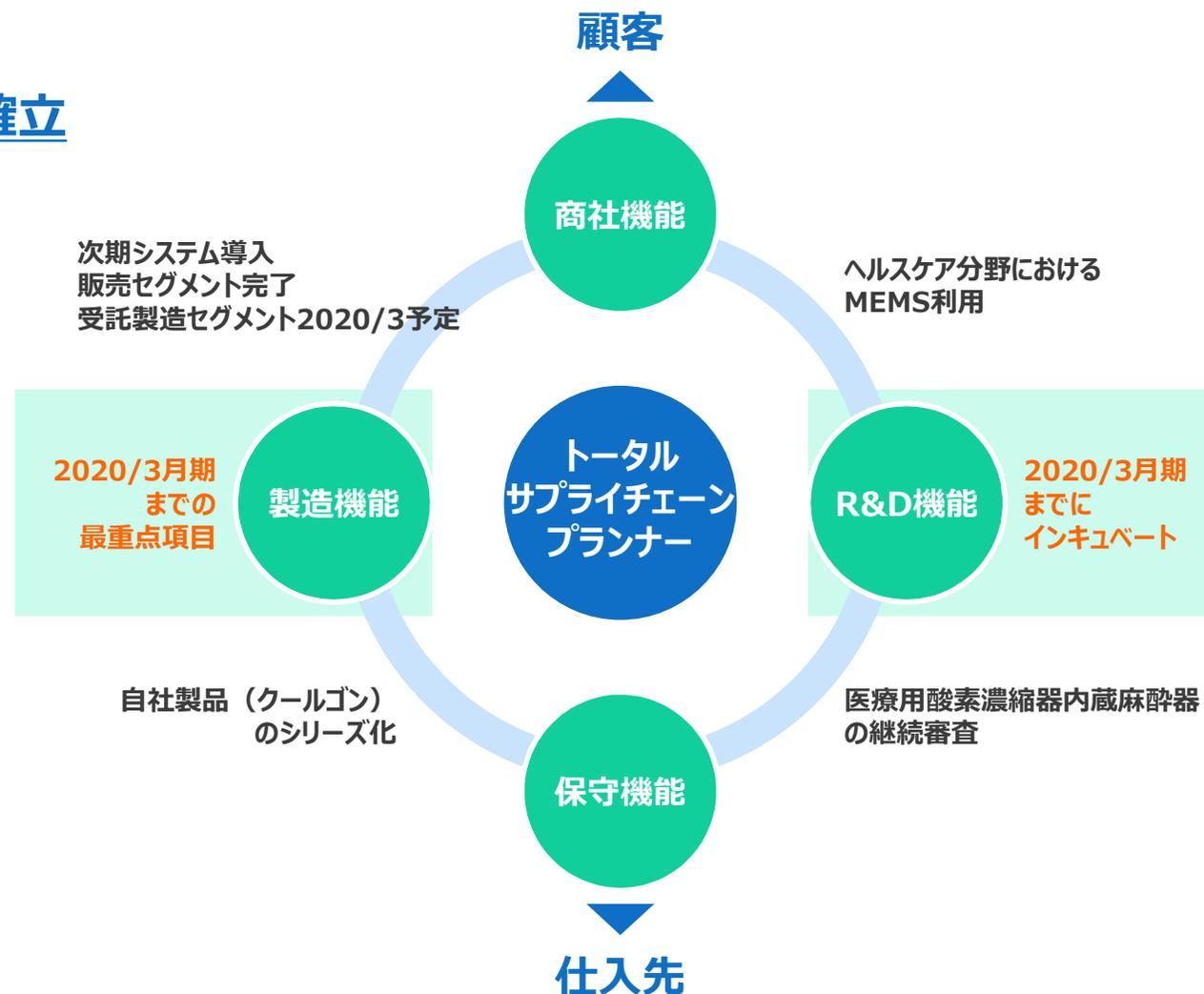
← 予想 →

トータル サプライチェーン プランナー企業

サプライチェーンにおける企業価値の確立

トータル サプライチェーン プランナー企業へ 4 機能強化

- I 商社機能の強化
⇒提案型商社/技術商社
- II 製造機能の強化
⇒請負から製造メーカーへ
(開発・調達・製造一気通貫)
- III メンテナンス機能の強化
⇒選択と集中
- IV R&D機能の強化
⇒新市場への挑戦
(自社・医療機器開発)



1 受託製造セグメントの設備投資は予定通り完了

- 一時的な半導体製造装置市場の減速はあるものの、主要顧客の成長を継続的キャッチアップする方針は変わらず
 - 👉 **現状は損益分岐点操業度であるが、2020年以降は増産を期待
(製造能力はセグメント売上高75億円まで拡大可能)**
- 設計、改造、組立、部品調達、スタートアップにいたる一貫サービスの技術力獲得
 - 👉 **特に、設計関連の技術者を拡充**
- 協力企業から自社技術を保有するメーカーへの脱皮
 - 👉 **開発案件の増加に対応し、技術部門の一層の強化を計画**
- 生産合理化の一環として、ERPシステムを2020年3月までに新規導入
(販売セグメントは2019年9月に導入完了)
 - 👉 **2020年3月までに並行稼働・準備を終了させ2020年6月にERPの一本化を予定**

2 収益性の高い事業への注力 / 合理化の推進

- 収益力の高い受託製造セグメントの拡大による、中期的な収益力の強化
 - ☞ 受託製造の装置組立については操業度向上
 - ☞ 保守メンテナンスについては：
 - ・ 地域・対応範囲の拡大を継続
 - ・ 成長が2019年上期の売上を下支え（前年上期比で増加）
 - ・ 海外対応等の取組み開始
- すべての間接部門の合理化推進（製造、営業、物流、管理）
 - ☞ 子会社との間接部門の統合による合理化を進行中
- 販売セグメントのロジスティクスをコストセンターからバリューセンターへ変革（新物流センターの機能・立地を再検討）
 - ☞ 物流センターの立地見直しにより、顧客へのジャストインタイムの商品供給・リードタイム短縮と在庫の圧縮を両立

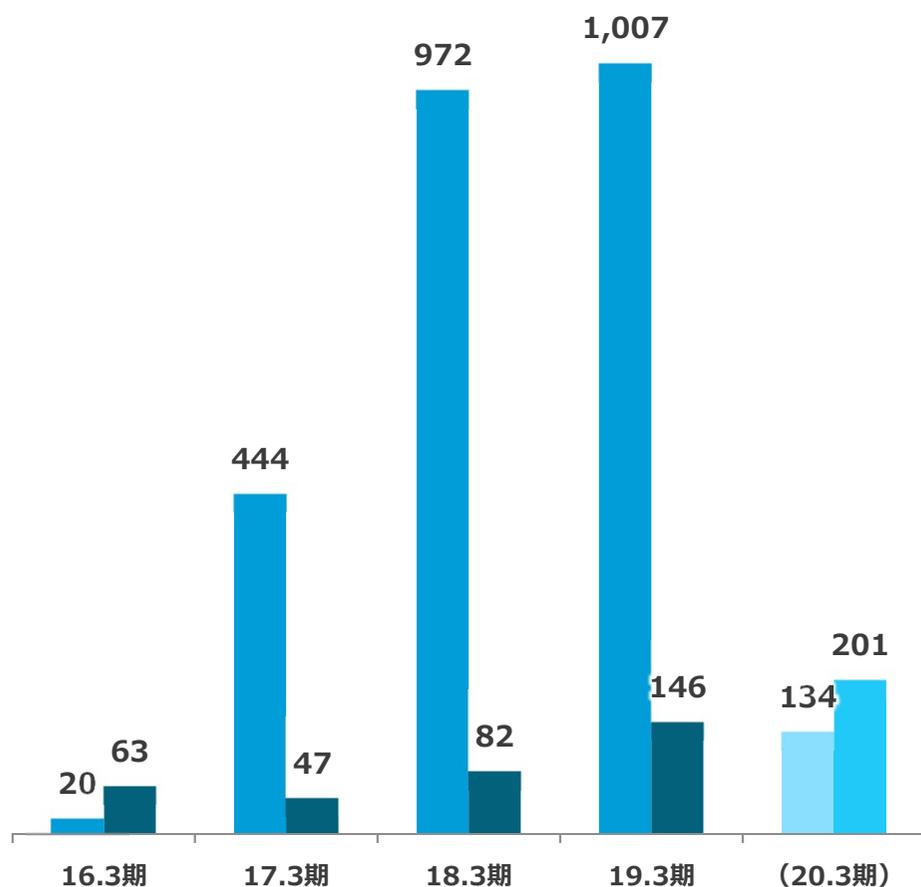
3 半導体製造装置の技術をコアに、周辺領域（FA）に市場拡大

- 半導体製造装置「エッチャー、成膜、フォトリソ、検査、洗浄」の熱、真空、空気圧、精密駆動機器等のコア技術を他市場に展開
- 中期的に新たな30億円程度の新市場を獲得
 - ・ 仕入先との協業による、FA分野の受託製造の領域拡大・強化
 - ・ センサーを活用したライフサイエンス事業については、2020年3月以降を目指した自社技術開発を中心としつつ、事業化のスピードアップを図るために他社との協業も視野

将来を見据えた受託製造の先行投資は、ほぼ一巡

(百万円)

■ 設備投資
■ 減価償却費



主要設備投資

● 17/3期

・内外エレクトロニクス 仙台事業所
第二工場新設 3.3億円

● 18/3期

・内外エレクトロニクス 仙台事業所
クリーンルーム新設・拡張 6.3億円
・内外テック 熊本県合志市
営業所・工場統合施設取得 1.5億円

● 19/3期

・内外エレクトロニクス 岩手県奥州市
工場用地取得 0.5億円
・内外エレクトロニクス 仙台事業所
第三工場新設 6.0億円
・内外テック 熊本営業所
営業所・工場統合施設改修 1.8億円
・内外エレクトロニクス 福島事業所
工場増改築 1.8億円

● 20/3期

・内外テック 熊本県合志市
メンテナンス施設・物流センター取得 1.3億円

今後の受注量増加に備え、新物流センターを新設予定

販売事業

新宮城物流センター 新棟
2020年9月 竣工予定



投資予定額 3.2億円

延床面積 1,465 m²

本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社